



2026年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2026年2月6日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <https://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長執行役員 (氏名) 三浦 宗男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経営企画本部長 (氏名) 中西 和彦

TEL 075 - 692 - 0251

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	36,930	5.9	3,685	43.5	3,696	47.8	2,627	49.0
2025年3月期第3四半期	39,259	22.6	6,521	60.0	7,082	64.0	5,152	65.5

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 7,588百万円 (98.2%) 2025年3月期第3四半期 3,828百万円 (33.8%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	35.02	—
2025年3月期第3四半期	68.70	—

(注) 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第3四半期	101,357	67,510	66.6
2025年3月期	83,228	61,386	73.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 67,510百万円 2025年3月期 61,386百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00
2026年3月期	—	0.00	—		
2026年3月期(予想)				20.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	54,500	1.9	7,000	21.2	7,000	25.5	4,950	39.0
								65.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(2026年2月6日)公表いたしました「2026年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期3Q	75,157,367 株	2025年3月期	75,140,556 株
期末自己株式数	2026年3月期3Q	129,181 株	2025年3月期	134,055 株
期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期3Q	75,018,018 株	2025年3月期3Q	75,001,774 株

- (注) 1. 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数(普通株式)を算定しております。
2. 期末自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
2. 決算説明資料及び決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米欧での利下げの動きを背景に持ち直しの傾向がみられたものの、中国経済の減速や地政学リスクが引き続き下押し要因となり、全体としては緩やかな回復にとどまりました。

半導体業界につきましては、AI・データセンタ向け需要の拡大が市場を引き続き牽引しました。特にメモリ分野では、超広帯域メモリ（HBM：High Bandwidth Memory）に加え、DRAMやNANDといった従来型メモリにおいても需給の逼迫や価格上昇が進展し、設備投資は回復基調で推移しました。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績は、米国の関税政策の影響に加え、車載用半導体の需要低迷が重なったことから売上高が減少し、製品ミックスにも影響が生じたことから、前年同期比で減収減益となりました。

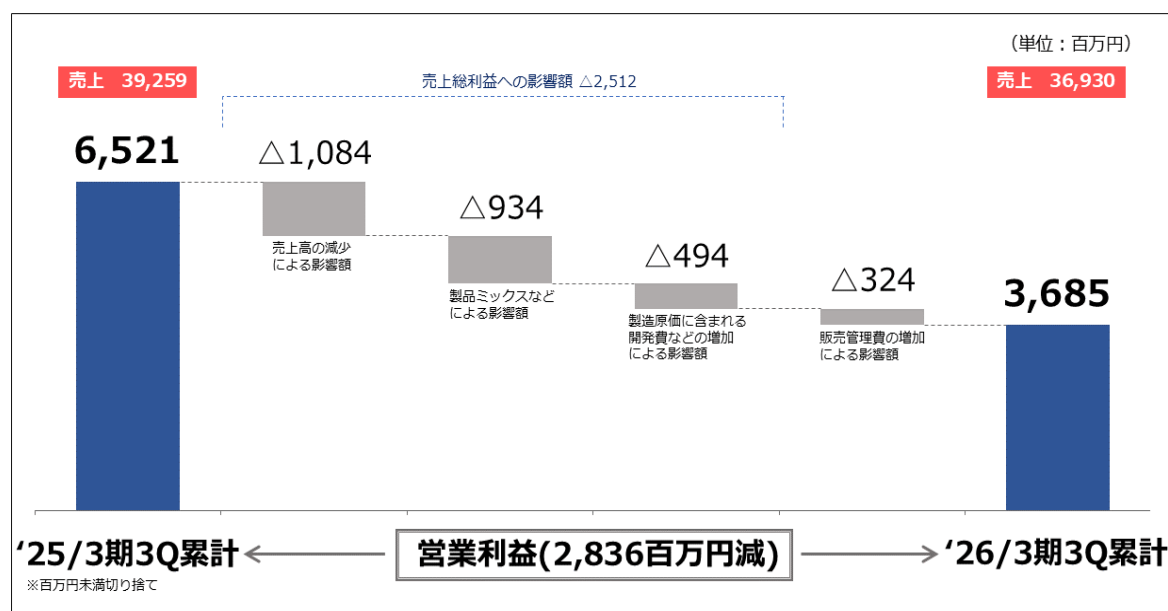
一方、受注高につきましてはメモリなどAI・データセンタ向けを中心に中国、台湾、その他アジア地域での受注が好調に推移し、第3四半期（2025年10月～12月期）における受注高は196億20百万円（前四半期比50億12百万円、34.3%増）となり、四半期ベースでは過去2番目の高水準を記録しました。こうした需要動向を背景に、受注残高も着実に積み上がっており、今後の業績に寄与するものと見込んでおります。

当第3四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	369億30百万円（前年同期比23億29百万円、5.9%減）
営業利益	36億85百万円（前年同期比28億36百万円、43.5%減）
経常利益	36億96百万円（前年同期比33億85百万円、47.8%減）
親会社株主に帰属する四半期純利益	26億27百万円（前年同期比25億25百万円、49.0%減）

当第3四半期連結累計期間の営業利益の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の減少による影響額	10億84百万円減
製品ミックスなどによる影響額	9億34百万円減
製造原価に含まれる開発費などの増加による影響額	4億94百万円減
販売管理費の増加による影響額	3億24百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

〔半導体製造装置事業〕

半導体製造装置事業における経営成績は、メモリ向けを中心にシンギュレーション装置の売上高が増加したほか、お客様の稼働率改善に伴いTSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高も増加しました。一方で、米国の関税政策の影響による投資の延期や見直し、EV市場の成長鈍化に伴う車載向け需要の低迷などにより、モールドディング装置の売上高が減少したことから、売上高は339億40百万円（前年同期比21億82百万円、6.0%減）となりました。利益につきましては、売上高の減少や一時的な製品ミックスの変動に伴い、営業利益は34億25百万円（前年同期比27億77百万円、44.8%減）となりました。

〔メディカルデバイス事業〕

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療用のプラスチック成形品や組立品の需要が堅調であったことから、売上高18億65百万円（前年同期比1億34百万円、7.8%増）となりました。利益につきましては、事業規模拡大に向けた人件費等の増加により営業利益3億46百万円（前年同期比22百万円、6.1%減）となりました。

〔レーザ加工装置事業〕

レーザ加工装置事業における経営成績は、主力製品であるレーザトリマ装置に対するお客様の設備投資が引き続き低迷している影響により、売上高11億24百万円（前年同期比2億81百万円、20.0%減）、営業損失86百万円（前年同期は営業損失50百万円）となりました。

（2）当四半期の財政状態の概況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ181億28百万円増加し1,013億57百万円となりました。これは、現金及び預金、棚卸資産等の流動資産及び固定資産が増加したことによるものです。

負債総額は、借入金及び買掛金等の増加により、前連結会計年度末に比べ120億5百万円増加し338億47百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ61億23百万円増加し675億10百万円となりました。

その結果、当第3四半期連結会計期間末における自己資本比率は66.6%（前連結会計年度末比7.2ポイント減少）となりました。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当初見込んでいた量産投資の時期が後ろ倒しとなったことや、評価用設備などリードタイムの長い製品の受注比率が高まったことから、売上計上の時期が期初計画から後ずれし、売上高は前回予想を下回る見通しです。また、売上高の減少に加え、製品ミックス変動の影響や初回納入に伴う追加コストの影響を受け、各段階利益も前回予想を下回る見込みです。前回予想比では売上高・各段階利益ともに下回るものの、当第2四半期以降の業績は着実に回復基調にあり、売上高は過去最高を更新する見通しです。

足元の受注環境はメモリなどAI・データセンタ向けを中心に堅調に推移しております。こうした需要動向を背景に、受注残高も着実に積み上がっており、今後の売上高に寄与するものと見込んでおります。また、コンプレッション装置の受注が増加しており、この傾向を踏まえると製品ミックスの改善が期待されます。さらに、一時的な要因である初回納入に伴う追加コストの影響が軽減されることから、利益についても改善するものと見込んでおります。

詳細につきましては、本日（2026年2月6日）公表いたしました「2026年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,338,921	29,936,322
受取手形及び売掛金	11,391,221	12,822,825
電子記録債権	351,247	133,333
リース債権及びリース投資資産	19,965	14,582
商品及び製品	3,828,829	5,122,876
仕掛品	10,223,352	11,785,294
原材料及び貯蔵品	1,795,319	1,967,004
その他	1,709,806	2,480,020
貸倒引当金	△6,364	△5,876
流動資産合計	50,652,299	64,256,385
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	22,949,252	24,625,005
減価償却累計額	△13,670,130	△14,528,575
建物及び構築物（純額）	9,279,121	10,096,430
機械装置及び運搬具	18,094,025	20,035,502
減価償却累計額	△12,434,302	△13,746,433
機械装置及び運搬具（純額）	5,659,723	6,289,068
土地	6,566,490	6,738,868
リース資産	1,685,684	1,917,932
減価償却累計額	△509,906	△669,888
リース資産（純額）	1,175,777	1,248,043
建設仮勘定	829,705	457,690
その他	5,248,194	5,672,777
減価償却累計額	△4,258,128	△4,632,169
その他（純額）	990,066	1,040,607
有形固定資産合計	24,500,885	25,870,708
無形固定資産	1,421,284	1,725,017
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	678,782	724,422
その他	5,975,234	8,780,752
投資その他の資産合計	6,654,017	9,505,174
固定資産合計	32,576,186	37,100,901
資産合計	83,228,486	101,357,287

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,551,525	4,554,806
電子記録債務	28,887	38,526
短期借入金	7,000,000	11,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,120,000	2,120,000
未払法人税等	1,222,764	956,224
製品保証引当金	313,722	318,579
賞与引当金	1,168,008	750,106
役員賞与引当金	117,231	50,590
その他	4,487,804	6,480,186
流動負債合計	18,009,944	26,269,019
固定負債		
長期借入金	1,370,000	4,530,000
退職給付に係る負債	1,014,238	1,057,592
株式給付引当金	82,967	123,288
その他	1,364,968	1,867,382
固定負債合計	3,832,173	7,578,263
負債合計	21,842,118	33,847,283
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,969,261	8,985,585
資本剰余金	464,571	480,895
利益剰余金	45,479,594	46,604,808
自己株式	△115,241	△110,316
株主資本合計	54,798,186	55,960,971
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,817,381	4,326,439
為替換算調整勘定	3,716,815	7,204,795
退職給付に係る調整累計額	53,984	17,797
その他の包括利益累計額合計	6,588,181	11,549,031
純資産合計	61,386,368	67,510,003
負債純資産合計	83,228,486	101,357,287

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	39,259,405	36,930,290
売上原価	24,688,529	24,871,416
売上総利益	14,570,875	12,058,873
販売費及び一般管理費	8,048,953	8,373,444
営業利益	6,521,922	3,685,429
営業外収益		
受取利息	126,568	126,722
受取配当金	110,375	114,282
為替差益	135,189	—
雑収入	299,513	263,683
営業外収益合計	671,646	504,688
営業外費用		
支払利息	63,922	107,385
為替差損	—	339,985
雑損失	47,433	45,948
営業外費用合計	111,355	493,319
経常利益	7,082,213	3,696,797
特別利益		
固定資産売却益	2,679	467
投資有価証券売却益	6,818	—
受取損害賠償金	—	87,588
特別利益合計	9,497	88,056
特別損失		
固定資産売却損	222	2,260
固定資産除却損	11,187	4,288
投資有価証券評価損	12,056	—
特別損失合計	23,467	6,548
税金等調整前四半期純利益	7,068,243	3,778,305
法人税等	1,915,309	1,151,146
四半期純利益	5,152,934	2,627,159
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,152,934	2,627,159

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	5,152,934	2,627,159
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,177,703	1,509,057
為替換算調整勘定	892,271	3,487,980
退職給付に係る調整額	△38,974	△36,186
その他の包括利益合計	△1,324,407	4,960,850
四半期包括利益	3,828,527	7,588,009
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,828,527	7,588,009

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

第1四半期連結会計期間において、TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD.、TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITEDを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

第2四半期連結会計期間において、和創半導体設備（深圳）有限公司を新たに設立したことに伴い、連結の範囲に含めております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	1,973,407千円	2,251,372千円
のれんの償却額	113,423千円	110,098千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自2024年4月1日 至2024年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	36,122,813	1,730,232	1,406,359	39,259,405
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	36,122,813	1,730,232	1,406,359	39,259,405
セグメント利益又は損失(△)	6,202,747	369,414	△50,239	6,521,922

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。

II 当第3四半期連結累計期間（自2025年4月1日 至2025年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	33,940,293	1,865,026	1,124,970	36,930,290
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	33,940,293	1,865,026	1,124,970	36,930,290
セグメント利益又は損失(△)	3,425,415	346,869	△86,855	3,685,429

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。